

# TP300 导热硅胶垫片

超柔软、高性能导热填缝材料

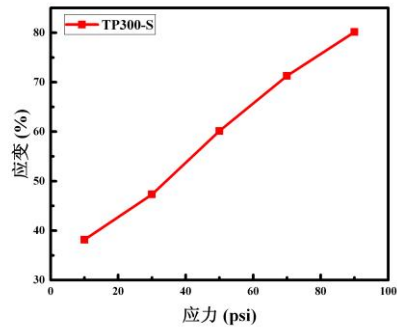
## 特性和优点

- 导热系数: 3.0 W/m.K
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 玻纤/PI膜加强可选
- 低压缩力应用，具有高压缩比

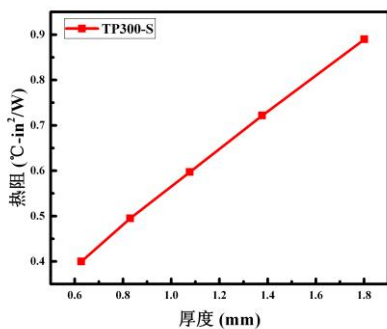


TP300导热硅胶垫片是一款超柔软的高导热性能的材料，在低压力的情况下表现出较小的热阻和很高的形变量，拥有非常好的填缝性能，推荐使用在公差比较大的平面。另外TP300具有自粘性，不需要额外的阻碍导热的粘胶涂层。

形变量与压力关系图



厚度与热阻性



## TP 300 的典型属性

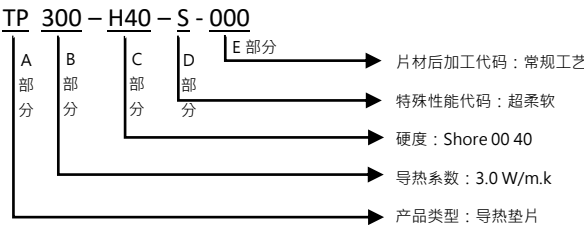
| 属性            | 公制值              | 测试方法       |
|---------------|------------------|------------|
| 组成部分          | 硅胶+陶瓷            | -          |
| 颜色            | 浅蓝色              | 目视         |
| 厚度(mm)        | 0.5~10.0         | ASTM D374  |
| 密度 (g/cc)     | 3.0              | ASTM D792  |
| 硬度 (Shore OO) | 40               | ASTM D2240 |
| 长期使用温度 (°C)   | -40~150          | -          |
| 电性能           |                  |            |
| 击穿电压 (Kv/mm)  | ≥6.0             | ASTM D149  |
| 介电常数 (@10MHz) | 7.3              | ASTM D150  |
| 体积电阻率 (Ω.cm)  | 10 <sup>13</sup> | ASTM D257  |
| 防火性能          | V-0              | UL 94      |
| 热性能           |                  |            |
| 导热系数 (W/m.K)  | 3.0              | ASTM D5470 |

\*厚度 $T \leq 0.75$  mm, 硬度 $H = \text{Shore OO } 50$

## 典型应用

- 显卡散热模块
- LCD背光模块
- 网络通信设备
- 高速大存储驱动
- 高导热需求的模块
- 汽车发动机控制单元
- 硬盘驱动和DVD驱动
- 笔记本和台式计算机

## 产品编码规则



标准尺寸: 200x400mm. 可依客户指定模切成各种尺寸或形状。厚度按照0.25mm递增。